

国家级继续医学教育I类学分项目办班申请表

举办单位(公章)：中国医科大学

项目名称	数字化印模在种植体上部修复的应用		
项目编号	2017-08-04-072 (国)		
项目负责人	战德松		
联系人	战德松		
单位联系电话			
手机	18040229199		
办班地点	中国医科大学口腔医学院九楼报告厅/沈阳锦冠桥义齿加工中心		
授予学分	4学分		
授课学时	12		
拟参加人数	80		
项目起止日期	2017.5.7-2017.5.9		
项目日程安排			
日期：2017.05.07			
时间	学时	会议内容	报告人
13:30-15:30	2	数字化在特殊病例中的应用	战德松
15:40-17:00	1	数字化口腔技术在种植修复上部结构修复中的应用	战德松
日期：2017.05.08			
时间	学时	会议内容	报告人
9:00-17:00	6	CAD-CAM全冠及嵌体 操作	刘志坚
日期：2017.05.09			
9:00-12:00	3	数字化基台设计及制作 操作	刘志坚
开班前两周将事前通知发到继续教育学院			

中国医科大学口腔医学院九楼报告厅

中国医科大学口腔医学院九楼报告厅

阳锦冠桥义齿加工中心

阳锦冠桥义齿加工中心